

香港交易及结算有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二五年第二季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2025年8月7日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二五年六月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二五年第二季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 5.661 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 4.6%。
- 毛利率 10.9%，同比上升 0.4 个百分点，环比上升 1.7 个百分点。
- 母公司拥有人应占利润 800 万美元，同比上升 19.2%，环比上升 112.1%。

二零二五年第三季度指引

- 我们预计销售收入约在 6.2 亿美元至 6.4 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 10%至 12%之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事白鹏博士对二零二五年第二季度业绩评论道：

“华虹半导体二零二五年第二季度销售收入达 5.66 亿美元，符合指引预期；毛利率为 10.9%，优于指引。销售收入和毛利率均实现环比增长，产能利用率亦创下近几个季度以来的新高。第二季度，在全球贸易及晶圆代工市场呈现一定波动的背景下，公司聚焦自身产品、工艺、研发、供应链等核心竞争力的提升，降本增效初见成果，主要营运指标持续改善。”

白总继续表示：“面对需求分化的半导体市场，公司坚持以特色工艺技术壁垒为锚，力争在关键技术平台实现技术突破，丰富产品组合。随着无锡新 12 英寸产线稳步推进产能爬坡，公司将实现产能规模到技术生态的全面升级。市场策略上，公司协同国内外战略客户需求，秉持国际化和开放的业务发展战略，做大做强全球客户群体。未来公司将继续积极布局各项战略规划，为提升公司在晶圆代工行业中的优势地位奠定坚实基础。”

电话会议公告

日期 2025 年 8 月 7 日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

05:00 美国东部时间

发言人： 白鹏，总裁兼执行董事

王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播： 会议将在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/pemdk6h6> 作在线直播

(请提前注册登记)

电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI1686ec5f75fa43e1a37307d2e98221ed>

重要提示：在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放： 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先进 “特色 IC + Power Discrete” 的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有 “8 英寸 + 12 英寸” 先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂, 其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	566,065	478,524	540,937	18.3 %	4.6 %
毛利	61,611	50,063	49,997	23.1 %	23.2 %
毛利率	10.9 %	10.5 %	9.2 %	0.4	1.7
经营开支	(97,917)	(90,328)	(97,110)	8.4 %	0.8 %
其他收入/(损失)净额	10,602	6,885	(8,294)	54.0 %	(227.8)%
税前损失	(25,704)	(33,380)	(55,407)	(23.0)%	(53.6)%
所得税(开支)/抵免	(7,097)	(8,368)	3,245	(15.2)%	(318.7)%
期内损失	(32,801)	(41,748)	(52,162)	(21.4)%	(37.1)%
净利润率	(5.8)%	(8.7)%	(9.6)%	2.9	3.8
以下各方应占:					
母公司拥有人	7,952	6,673	3,750	19.2 %	112.1 %
非控股权益	(40,753)	(48,421)	(55,912)	(15.8)%	(27.1)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.005	0.004	0.002	25.0 %	150.0 %
摊薄	0.005	0.004	0.002	25.0 %	150.0 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,305	1,106	1,231	18.0 %	6.0 %
产能利用率 ¹	108.3 %	97.9 %	102.7 %	10.4	5.6
净资产收益率 ²	0.4 %	0.4 %	0.4 %	-	-

二零二五年第二季度

- 销售收入 5.661 亿美元, 同比增长 18.3%, 环比增长 4.6%, 主要得益于付运晶圆数量上升。
- 毛利率 10.9%, 同比上升 0.4 个百分点, 主要得益于产能利用率提升及平均销售价格上涨, 部分被折旧成本上升所抵消; 环比上升 1.7 个百分点, 主要得益于产能利用率提升。
- 经营开支 9,790 万美元, 同比上升 8.4%, 主要由于研发工程片开支及折旧开支上升; 环比上升 0.8%。
- 其他收入净额 1,060 万美元, 同比上升 54.0%, 主要得益于外币汇兑损失及财务费用下降及政府补贴上升, 部分被利息收入下降所抵消; 相比上季度其他损失净额 830 万美元, 主要由于外币汇兑损失及财务费用下降。
- 所得税开支 710 万美元, 同比下降 15.2%, 主要由于应课税利润下降。
- 期内损失 3,280 万美元, 上年同期为 4,170 万美元, 上季度为 5,220 万美元。
- 母公司拥有人应占利润 800 万美元, 同比上升 19.2%, 环比上升 112.1%。
- 基本每股盈利 0.005 美元, 同比上升 25%, 环比上升 150%。
- 净资产收益率(年化) 0.4%, 同比及环比均持平。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	541,076	95.6 %	453,345	94.7 %	87,731	19.4 %
其他	24,989	4.4 %	25,179	5.3 %	(190)	(0.8)%
销售收入总额	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

■ 本季度 95.6%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	232,308	41.0 %	245,471	51.3 %	(13,163)	(5.4)%
12 吋晶圆	333,757	59.0 %	233,053	48.7 %	100,704	43.2 %
销售收入总额	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

■ 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.323 亿美元及 3.338 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	469,674	83.0 %	385,519	80.5 %	84,155	21.8 %
北美 ⁴	53,007	9.4 %	46,829	9.8 %	6,178	13.2 %
亚洲其他 ⁵	28,647	5.0 %	29,003	6.1 %	(356)	(1.2)%
欧洲	14,737	2.6 %	17,173	3.6 %	(2,436)	(14.2)%
销售收入总额	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度来自于中国的销售收入 4.697 亿美元，占销售收入总额的 83.0%，同比增长 21.8%，主要得益于其他电源管理、超级结、模拟及逻辑产品的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 5,300 万美元，同比增长 13.2%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲其他地区的销售收入 2,860 万美元，同比下降 1.2%。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,470 万美元，同比下降 14.2%，主要由于通用 MOSFET 产品的需求下降。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴ 包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵自 2025 年第二季度起包括日本。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	141,158	24.9 %	137,126	28.7 %	4,032	2.9 %
独立式非易失性存储器	27,603	4.9 %	23,675	4.9 %	3,928	16.6 %
功率器件	166,713	29.5 %	152,371	31.8 %	14,342	9.4 %
逻辑及射频	68,589	12.1 %	63,487	13.3 %	5,102	8.0 %
模拟与电源管理	161,154	28.5 %	101,137	21.1 %	60,017	59.3 %
其他	848	0.1 %	728	0.2 %	120	16.5 %
销售收入总额	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.412 亿美元，同比增长 2.9%，主要得益于 MCU 产品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求下降所抵消。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 2,760 万美元，同比增长 16.6%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度功率器件销售收入 1.667 亿美元，同比增长 9.4%，主要得益于超级结及通用 MOSFET 产品需求增加。
- 本季度逻辑及射频销售收入 6,860 万美元，同比增长 8.0%，主要得益于逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.612 亿美元，同比增长 59.3%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	125,537	22.2 %	98,550	20.6 %	26,987	27.4 %
90nm 及 95nm	145,447	25.7 %	95,285	19.9 %	50,162	52.6 %
0.11μm 及 0.13μm	64,011	11.3 %	68,660	14.3 %	(4,649)	(6.8)%
0.15μm 及 0.18μm	29,059	5.1 %	30,508	6.4 %	(1,449)	(4.7)%
0.25μm	1,174	0.2 %	2,436	0.5 %	(1,262)	(51.8)%
0.35μm 及以上	200,837	35.5 %	183,085	38.3 %	17,752	9.7 %
销售收入总额	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入 1.255 亿美元，同比增长 27.4%，主要得益于模拟、逻辑及闪存产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.454 亿美元，同比增长 52.6%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工艺技术节点的销售收入 6,400 万美元，同比下降 6.8%，主要由于 MCU 及智能卡芯片产品的需求下降，部分被逻辑产品需求增加所抵消。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工艺技术节点的销售收入 2,910 万美元，同比下降 4.7%。
- 本季度 0.25μm 工艺技术节点的销售收入 120 万美元，同比下降 51.8%，主要由于功率器件产品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工艺技术节点的销售收入 2.008 亿美元，同比增长 9.7%，主要得益于超级结、通用 MOSFET 及其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按终端市场分布划分的 销售收入	二零二五年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第二季度 % (未经审核)	二零二四年 第二季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第二季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
消费电子	357,370	63.1 %	298,320	62.4 %	59,050	19.8 %
工业及汽车	129,150	22.8 %	110,643	23.1 %	18,507	16.7 %
通信	71,638	12.7 %	59,486	12.4 %	12,152	20.4 %
计算	7,907	1.4 %	10,075	2.1 %	(2,168)	(21.5)%
销售收入总额	566,065	100.0 %	478,524	100.0 %	87,541	18.3 %

- 本季度消费电子作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 3.574 亿美元，占销售收入总额的 63.1%，同比增长 19.8%，主要得益于其他电源管理、超级结、逻辑及通用 MOSFET 产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.292 亿美元，同比增长 16.7%，主要得益于 MCU 及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度通信类产品销售收入 7,160 万美元，同比增长 20.4%，主要得益于模拟产品的需求增加。
- 本季度计算类产品销售收入 790 万美元，同比下降 21.5%，主要由于 MCU、模拟及逻辑产品的需求下降。

产能⁶及产能利用率

	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	447	391	413
总体产能利用率	108.3%	97.9%	102.7%

- 本季度末月产能 447,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 108.3%，较上季度上升 5.6 个百分点。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,305	1,106	1,231	18.0 %	6.0 %

- 本季度付运晶圆 1,305,000 片，同比上升 18.0%，环比上升 6.0%。

⁶ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

经营开支分析

以千美元计	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,630	2,785	2,214	(5.6)%	18.8 %
管理费用 ⁷	95,287	87,543	94,896	8.8 %	0.4 %
经营开支	97,917	90,328	97,110	8.4 %	0.8 %

- 经营开支 9,790 万美元，同比上升 8.4%，主要由于研发工程片开支及折旧开支上升；环比上升 0.8%。

其他收入/(损失)净额

以千美元计	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,460	3,558	3,513	(2.8)%	(1.5)%
利息收入	15,294	29,787	15,619	(48.7)%	(2.1)%
汇兑损失	(1,064)	(7,921)	(16,199)	(86.6)%	(93.4)%
分占联营公司溢利	591	1,394	652	(57.6)%	(9.4)%
财务费用	(18,250)	(24,847)	(23,301)	(26.6)%	(21.7)%
政府补贴	9,866	4,778	11,231	106.5 %	(12.2)%
其他	705	136	191	418.4 %	269.1 %
其他收入/(损失)净额	10,602	6,885	(8,294)	54.0 %	(227.8)%

- 其他收入净额 1,060 万美元，同比上升 54.0%，主要得益于外币汇兑损失及财务费用下降及政府补贴上升，部分被利息收入下降所抵消；相比上季度其他损失净额 830 万美元，主要由于外币汇兑损失及财务费用下降。

⁷管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二四年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	169,630	96,890	50,186	75.1 %	238.0 %
投资活动所用现金流量净额	(385,556)	(171,973)	(494,291)	124.2 %	(22.0)%
融资活动所(用)/得现金流量净额	(25,185)	416,148	59,137	(106.1)%	(142.6)%
外汇汇率变动影响净额	8,076	(25,185)	5,771	(132.1)%	39.9 %
现金及现金等价物变动影响净额	(233,035)	315,880	(379,197)	(173.8)%	(38.5)%

- 本季度经营活动所得现金流量净额 1.696 亿美元，同比上升 75.1%，环比上升 238.0%，主要得益于客户收款增加。
- 投资活动所用现金流量净额 3.856 亿美元，其中包括固定资产投资支出 4.077 亿美元，及对联营企业投资 280 万美元，部分被利息收入 1,940 万美元及，收到政府对设备的补助 550 万美元所抵消。
- 融资活动所用现金流量净额 2,520 万美元，其中偿还银行借款 1.257 亿美元，支付利息 3,860 万美元，及支付租赁负债 120 万美元，部分被提取银行借款 1.381 亿美元，及员工行权发行股份收到 220 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)
资产总额	12,237,080	12,286,786
负债总额	3,363,437	3,406,124
所有者权益总额	8,873,643	8,880,662
资产负债率 ⁸	27.5%	27.7%

资本开支

以千美元计	二零二五年 第二季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)
华虹 8 吋	17,612	14,264
华虹无锡	13,676	18,402
华虹制造	376,440	478,185
合计	407,728	510,851

- 本季度资本开支 4.077 亿美元，其中 3.764 亿美元用于华虹制造，1,760 万美元用于华虹 8 吋，及 1,370 万美元用于华虹无锡。

⁸资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)
发展中物业	221,661	221,061
存货	513,434	468,597
贸易应收款项及应收票据	264,329	286,763
预付款项、其他应收款项及其他资产	452,513	411,207
应收关联方款项	14,360	16,520
已冻结存款及定期存款	31,756	31,669
现金及现金等价物	3,846,900	4,079,935
流动资产总额	5,344,953	5,515,752
贸易应付款项	263,352	255,321
其他应付款项及暂估费用	716,648	759,177
计息银行借款	341,313	329,972
租赁负债	5,839	7,543
政府补助	59,040	57,700
应付关联方款项	8,560	12,724
应付所得税	16,046	18,620
流动负债总额	1,410,798	1,441,057
净营运资金	3,934,155	4,074,695
速动比率	3.3x	3.3x
流动比率	3.8x	3.8x
贸易应收款项及应收票据周转天数	44	46
存货周转天数	88	86

- 存货由上季度末的 4.686 亿美元上升至本季度末的 5.134 亿美元，主要由于新工厂的在制品及产成品增加。
- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 4.112 亿美元上升至本季度末的 4.525 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 7.592 亿美元下降至本季度末的 7.166 亿美元，主要由于本季度支付应付资本开支。
- 计息银行借款由上季度末的 3.300 亿美元上升至本季度末的 3.413 亿美元，主要由于一年内到期的长期银行借款增加。
- 净营运资金 本季度末 39.342 亿美元，流动比率 3.8。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 44 天。
- 存货周转天数 88 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)
销售收入	566,065	478,524	540,937
销售成本	(504,454)	(428,461)	(490,940)
毛利	61,611	50,063	49,997
其他收入及收益	29,353	38,259	30,563
销售及分销费用	(2,630)	(2,785)	(2,214)
管理费用	(95,287)	(87,543)	(94,896)
其他费用	(1,092)	(7,921)	(16,208)
财务费用	(18,250)	(24,847)	(23,301)
分占联营公司溢利	591	1,394	652
税前损失	(25,704)	(33,380)	(55,407)
所得税(开支)/抵免	(7,097)	(8,368)	3,245
期内损失	(32,801)	(41,748)	(52,162)
以下各方应占：			
母公司拥有人	7,952	6,673	3,750
非控股权益	(40,753)	(48,421)	(55,912)
持有人应占每股盈利			
基本	0.005	0.004	0.002
摊薄	0.005	0.004	0.002
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,726,241,791	1,716,917,408	1,721,931,435
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,731,895,843	1,720,532,998	1,728,142,630

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	6,101,971	5,967,555	3,750,176
投资物业	218,468	209,257	165,611
使用权资产	66,002	76,359	80,629
无形资产	27,313	29,122	42,320
于联营公司的投资	144,421	140,650	141,036
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	290,515	289,722	285,938
长期预付款项	42,672	57,989	139,425
递延税项资产	765	380	629
非流动资产总额	6,892,127	6,771,034	4,605,764
流动资产			
发展中物业	221,661	221,061	207,151
存货	513,434	468,597	462,563
贸易应收款项及应收票据	264,329	286,763	274,382
预付款项、其他应收款项及其他资产	452,513	411,207	75,761
应收关联方款项	14,360	16,520	16,034
已冻结存款及定期存款	31,756	31,669	39,259
现金及现金等价物	3,846,900	4,079,935	6,423,866
流动资产总额	5,344,953	5,515,752	7,499,016
流动负债			
贸易应付款项	263,352	255,321	246,206
其他应付款项及暂估费用	716,648	759,177	505,945
计息银行借款	341,313	329,972	247,034
租赁负债	5,839	7,543	4,674
政府补助	59,040	57,700	39,359
应付关联方款项	8,560	12,724	8,340
应付所得税	16,046	18,620	19,038
流动负债总额	1,410,798	1,441,057	1,070,596
流动资产净额	3,934,155	4,074,695	6,428,420
总资产减流动负债	10,826,282	10,845,729	11,034,184
非流动负债			
计息银行借款	1,933,971	1,948,409	1,964,956
租赁负债	15,035	15,160	19,440
递延税项负债	3,633	1,498	4,892
非流动负债总额	1,952,639	1,965,067	1,989,288
净资产	8,873,643	8,880,662	9,044,896
权益和负债权益			
股本	4,960,855	4,957,182	4,935,470
储备	1,339,047	1,315,995	1,333,799
本公司拥有人应占权益	6,299,902	6,273,177	6,269,269
非控股权益	2,573,741	2,607,485	2,775,627
权益总额	8,873,643	8,880,662	9,044,896

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)	于六月三十日 二零二四年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)
经营活动现金流量：			
税前亏损	(25,704)	(33,380)	(55,407)
折旧及摊销	179,658	136,881	172,126
应占联营公司溢利	(591)	(1,394)	(652)
营运资金的变动及其它	16,267	(5,217)	(65,881)
经营活动所得现金流量净额	169,630	96,890	50,186
投资活动现金流量：			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(407,728)	(196,830)	(510,851)
投资联营企业	(2,794)	-	-
其他投资活动所得现金流量	24,966	24,857	16,560
投资活动所用现金流量净额	(385,556)	(171,973)	(494,291)
融资活动现金流量：			
提取银行贷款	138,096	99,042	860,985
发行股份所得收益	2,218	579	13,077
偿还银行贷款	(125,677)	(87,530)	(811,156)
已付利息	(38,623)	(49,800)	(3,252)
支付租赁负债	(1,199)	(2,348)	(517)
非控股权益资本注资	-	492,450	-
支付股息	-	(36,245)	-
融资活动所(用)/得现金流量净额	(25,185)	416,148	59,137
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(241,111)	341,065	(384,968)
期初现金及现金等价物	4,079,935	6,107,986	4,459,132
外汇汇率变动影响净额	8,076	(25,185)	5,771
期末现金及现金等价物	3,846,900	6,423,866	4,079,935

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

唐均君(董事长)

白鹏(总裁)

非执行董事

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂壘太平绅士

封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司

唐均君

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二五年八月七日